

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-010

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司表面贴装温度补偿振荡器（TCXO）产品通过MTK认证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司工程技术人员努力研制的表面贴装温度补偿振荡器（TCXO）产品（2TG2600001）日前通过联发科技股份有限公司（MTK）的方案认证，该方案主要应用于消费类电子产品的GPS功能。

该事项对公司短期业绩无重大影响，对公司未来业绩提升影响尚无法评估。敬请广大投资者注意投资风险。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2018年3月22日